

2006年8月25日

報道関係者各位

C K D株式会社
<http://www.ckd.co.jp/>

半導体関連機器製品の受注増と中期経営計画達成のために
春日井事業所内にクリーンルーム工場を増設いたします。

半導体業界をはじめとする各業界の設備投資が活発化しており、中期計画の売上高1,000億円達成に向け、受注の拡大をはかっていますが生産能力が不足しており、これに対応すべく、春日井事業所内の半導体関連機器製品の加工・組立工場を増設いたします。

昨年夏以降、半導体関連機器製品の受注が活発となり、現在の生産状況はフル稼働の状況にあります。半導体製造装置業界が好調であり、この景況はしばらく継続するものと考えています。

中期的には自動車に搭載する半導体も増加し、半導体製造装置の需要が見込まれます。

今後、春日井事業所は半導体関連機器製品の主力工場と位置付けます。

今回の設備投資を含めると、今年の設備投資は当初計画70億円を上回り、約100億円となり、昨年の設備投資額（約22億円）に比べ約4倍となります。

1. 建設規模概要

南北55m×東西46m×高さ18.5m

延べ床面積 6,550㎡、鉄骨造りの3階建て

1階は加工工場、

2・3階は組立工場（クリーンルーム・防塵室などを設置）

2. 投資総額

約31億円（新工場の建設費、付帯設備費、加工機、組立機等を含む）

3. 工期

2006年 9月上旬 建設着工予定

2007年 2月下旬 竣工予定

ご参考 既に発表した今年の設備投資の内容について

3月24日に発表した本社工場の工場建設の概要

用途 液晶用バックライト製造装置などの自動機械の組立工場

建築概要 南北93m×東西48m×高さ15m

延べ床面積 6,192㎡、鉄骨作りの一部2階建て

投資額 約15億円

工期 2006年6月中旬 建設着工予定

2006年12月上旬 竣工予定

4月28日に発表した四日市事業所の管理棟・工場建設の概要

用途 機器製品の受注増に対応するため加工・組立工場と管理棟

建築概要 加工・組立工場(第3工場)

南北114m×東西72m×高さ11m

延べ床面積 16,416㎡、鉄骨造りの総2階建て

1階は部品加工工場、2階は組立工場

管理棟

南北40m×東西30m×高さ15m

延べ床面積 3,600㎡、鉄骨造りの総3階建て

技術・品質保証・生産管理などのスタッフ部門と厚生施設

投資額 約28億円

工期 2006年6月中旬 建設着工予定

2006年12月上旬 竣工予定

問い合わせ先 CKD株式会社 総務部 坪井または杉浦まで

TEL: 0568-74-1238

FAX: 0568-71-4322

